

无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函

无锡宝通科技股份有限公司(下称“公司”或“宝通科技”)拟非公开发行股票，本人作为公司的董事及/或高级管理人员，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定，现就公司本次非公开发行股票摊薄股东即期回报填补措施能够得到切实履行等相关事项，特承诺如下：

- (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
- (7) 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此承诺！

(以下无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签字页)

(本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签字页)

无锡宝通科技股份有限公司全体董事签字：

无锡宝通科技股份有限公司全体高级管理人员(除担任董事的高级管理人员)签字：

年 月 日